

概要

この通知は、Spartan®/-XL/-II/-IIE/-3/-3E/-3A/-3AN/-3ADSP/-6、XC95XXX、XC95XXXXL、Virtex®、Virtex®-E、Virtex®-II/-II Pro、CoolRunner™、および CoolRunner™-II 製品のワイヤ ボンド BGA パッケージ基板のコア材とプリプレグ材のサプライヤーが追加されることをお知らせするものです。

内容

先日日本で発生した地震の影響によって、ワイヤボンド パッケージ基板のコアおよびプリプレグ層に使用されている Bismaleimide-Triazine (BT) 樹脂材の不足が世界各地で生じています。安定した供給を継続するため、コア材およびプリプレグ材の追加サプライヤーの評価を進めています。新しいサプライヤーとして Nanya、Hitachi、および Doosan が追加されます。フォーム、形状、および機能は、以前のパッケージ材質と同じです。

該当製品

[表 1](#) に、該当製品を示します。特定のデバイスが該当しているかどうかのご質問については、「お問い合わせ」セクションをご覧ください。パッケージ変更は、XC コマーシャル (C) およびインダストリアル (I) グレード デバイスの全 Production スピードグレード、パッケージ、温度範囲の製品に該当します。XA オートモーティブ、XQ および Q グレード デバイスには、この変更による影響はなく、これらのデバイスが新しい部材でリリースされることはありません。

表 1: 該当製品

製品ファミリ	デバイス名	パッケージピンの数
CoolRunner-II	XC2CXXXX/XC2CXXXXA	CP(G)56 ; CP(G)132; FT(G)256
CoolRunner	XCRXXXXX	CS(G)48; CP(G)56; FT(G)256
EasyPath	XCEXXXX	FG256
Spartan-II	XC2SXXXX	FG(G)256; FG(G)456
Spartan-IIE	XC2SXXXXE	FT(G)256; FG(G)456; FG(G)676
Spartan-3	XC3SXXXX	FT(G)256; FG(G)320; FG(G)456; FG(G)676; FG(G)900; FG1156
Spartan-3A	XC3SXXXXA	FT(G)256; FG(G)320; FG(G)400; FG(G)484; FG(G)676
Spartan-3A DSP	XC3SDXXXXA	CS(G)484; FG(G)676
Spartan-3AN	XC3SXXXXAN	FT(G)256; FG(G)400; FG(G)484; FG(G)676
Spartan-3E	XC3SXXXXE	FT(G)256; CP(G)132; FG(G)320; FG(G)400; FG(G)484
Spartan-6	XC6SLXXXX	FT(G)256; CS(G)225; CS(G)324; CS(G)484; FG(G)484; FG(G)676; FG(G)900
Spartan-XL	XCSXXXXL	BG(G)256
Virtex	XCVXXX	BG(G)256; FG(G)256
Virtex-II	XC2VXXX	BG(G)575; BG(G)728; FG(G)256; FG(G)456; FG(G)676
Virtex-II Pro	XC2VPXXX	FG(G)256; FG(G)456; FG(G)676
Virtex-E	XCVXXXXE	FG(G)256; FG(G)456; FG(G)900; FG1156
XC40XXXXLA	XC40XXXXLA	BG(G)256; BG(G)352; BG(G)432
XC95XXXXL	XC95XXXXL	CS(G)48; FG(G)256
XC95XXX	XC95XXX	CS(G)48

キーデートおよび混在出荷情報

ザイリンクスは、デートコード 1125 以降、追加サプライヤーによるコア材およびプリプレグ層を使用した製品の出荷を開始します。このデートコード後に標準製品番号で注文された場合、MGC コア サプライヤーまたはその他のコア サプライヤーで製造された製品が出荷されます。

品質評価データ

ザイリンクス デバイス/パッケージを使用した、Nanya、Hitachi、Doosan のコアおよびプリプレグ材の品質評価は問題なく、完了しています。表 2 に示す評価結果サマリに基づき、新しいサプライヤーが提供する基材コアは十分な結果を示し、ワイヤ ボンド BGA パッケージ製品アセンブリの品質要件を満たしました。詳細は、[RPT155](#) を参照してください。

表 2： 品質評価のサマリ

ザイリンクス デバイス	パッケージ	アセンブリ サプライヤー	基材コアの サプライヤー	条件付き	温度サイクル 「C」条件 (T/C-C)	HAST (高度加速 ストレス テスト)	UHAST (バイアス なし、高度加速 ストレス テスト)
XC2V3000	FGG676	SPIL	Nanya	Pass	Pass	NA	NA
XC3S1200E	FTG256	SPIL	Nanya	Pass	Pass	NA	NA
XC6SLX45T	FGG484	SPIL	Nanya	Pass	NA	Pass	NA
XC6SLX16	CSG324	SPIL	Nanya	Pass	NA	Pass	NA
XC3SD3400A	CSG484	SPIL	Hitachi	Pass	Pass	Pass	NA
XC3S1400A	FGG676	SPIL	Hitachi	Pass	Pass	Pass	NA
XC3S400A	FTG256	AMKOR	Doosan	Pass	Pass	Pass	NA
XC2S150	FGG456	AMKOR	Doosan	Pass	Pass	NA	Pass

お問い合わせ

この通知に対する回答は必要ありません。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせください。

重要なお知らせ：ザイリンクス カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースの通知は、サポートウェブサイト (<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができる サービスを提供しています。登録方法は、ザイリンクス アンサー #18683 を参照してください。

<http://japan.xilinx.com/support/answers/18683.htm>

参考資料

品質評価レポート (RPT155)

<https://secure.xilinx.com/webreg/clickthrough.do?cid=173270>

改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2011/06/13	1.0	初版リリース
2011/06/15	1.0.1	ザイリンクス製品番号を修正。
2011/07/25	2.0	切り替えの日付を含むようにキーデートおよび混在出荷情報を更新。品質評価データ セクションに品質評価レポート (RPT155) のリリースを反映。

Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials, or to advise you of any corrections or update. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of the Limited Warranties which can be viewed at <http://www.xilinx.com/warranty.htm>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in Critical Applications: <http://www.xilinx.com/warranty.htm#critapps>.

この通知は参照用として、英語版 (XCN11018、バージョン 2.0、2011 年 7 月 25 日発行) を翻訳したものです。